3 1,29

映次

13.5.21

映次

Rev: A

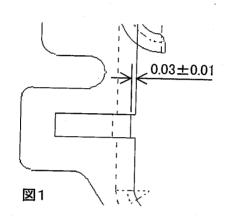
SQM-22020-1

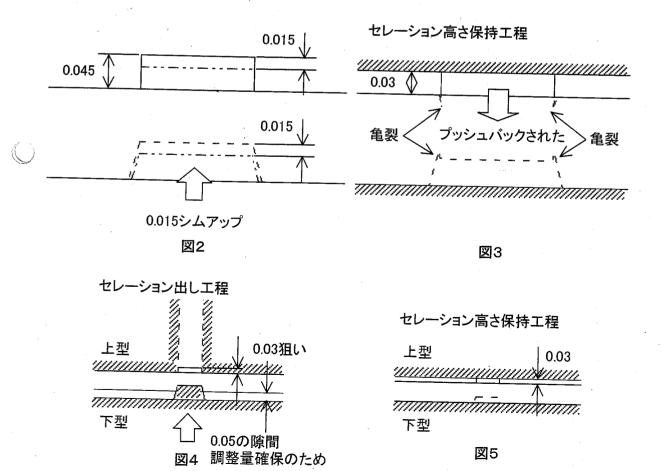
金型的原因

セレーション深さ0.03を社内公差±0.01(図1)で管理しておりますが、12.10.26S1V0001生産前の全面研磨時に下限側にあると判断し、下型のセレーション成形ダイを0.015シムアップしました(図2)。その為、図3に示しますようにセレーション高さ保持工程でプッシュバックされ亀裂が入ったものと考えます。

金型の工程は図4,5のようになっております。図4に示しますように下型のセレーション成形ダイは調整量確保のためダイ面より0.05隙間を設けており、容易に調整が出来る状態にありました。メンテナンス者は図5のセレーション高さ保持工程の存在を知らずシムアップをしてしまいました。その為、この度の亀裂発生に至ったものです。

セレーション高さ保持工程は、セレーション深さ0.03±0.01と厳しい公差管理の基に念のため導入しており、金型起工時に今回発生した割れ現象について予測が出来ておりませんでした。





金型的対策

下記の対策を実施し発生防止をしました。

- ①下型のセレーション成形ダイに設けてありました調整量確保のための0.05の隙間をゼロにし調整が出来ないようにしました。また安易にこの部品図を変更しない様、図面上に注意喚起コメントを記載しました。(図6)
- ②セレーション高さ保持工程では上型の部品を削除しました。削除した事により寸法への影響はありませんでした。(図7)
- ③メンテナンス者に対し金型工程を把握させるため、金型受入時に各工程の内容が明確に記載されたレイアウト図を添付してもらう事します。(2012.11月末)

また、修理箇所の型構造について把握をしてから、修理に取りかかることを指導しました。 (2012.11.21)

